

2018年中国PCB行业分析报告- 市场运营态势与发展前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国PCB行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/316069316069.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

2016年，全球PCB行业呈现三大特点：需求疲弱、新技术的冲击以及原材料涨价。Prismark数据显示，2016年PCB市场规模为542.07亿美元，同比下滑2%，除了中国以外其他地区均有所下滑。首先是PC、平板电脑以及高端智能手机市场需求增速下滑，Gartner最新数据指出，Q3季度全球PC行业持续下滑，总出货量6700万台同比下滑3.6%；其次苹果iphone 7的A10处理器率先采用无封装基板的Fo-WLP封装，极大程度上冲击了封装基板市场的发展，诸如日本Ibiden、韩国三星电机大型IC封装基板的厂商也面临着寻求新的PCB市场维稳企业发展的课题（Prismark）；原材料突然涨价，2016年铜价最高涨幅达37.7%，由于新能源汽车的兴起部分铜箔产能转向锂电铜箔，铜箔基板也由于供货紧张价格急剧上涨，产业链陷入恐慌。

图：全球PCB市场规模及增速（亿美元）

图：2016Q1-2017Q3全球PC出货量（千台）

图：苹果A10处理器

图：Fan-Out WLP封装流程

表：2016年全球前30名PCB制造商排名（百万美元）

观研天下发布的《2018年中国PCB行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

1.1 PCB的介绍

1.1.1 PCB的定义

1.1.2 PCB的分类

1.1.3 PCB的历史

1.2 PCB的产业链

1.2.1 PCB产业链的构成

1.2.2 产业链中的产品介绍

第二章 2016-2017年国际PCB产业发展分析

2.1 2016-2017年全球PCB产业发展概况

2.1.1 国际重点PCB制造企业的概述

2.1.2 2017年全球PCB工业发展回顾

2.1.3 2017年全球PCB行业发展状况

2.1.4 2016-2017年全球PCB产业发展综述

2.1.5 国外印制电路板制造技术的发展

2.2 美国

2.2.1 美国PCB产业的发展概况

2.2.2 美国PCB主要生产厂家的发展

2.2.3 北美PCB产业发展现状

2.3 欧洲

2.3.1 欧洲PCB产业发展概况

2.3.2 2017年欧洲PCB行业发展开始恢复

2.3.3 2016-2017年德国PCB产业的发展

2.4 日本

2.4.1 日本PCB产业的发展阶段

2.4.2 日本PCB产业的发展回顾

2.4.3 2016-2017年日本PCB产业的发展

2.4.4 日本领先PCB厂商发展高端路线

2.5 台湾地区

2.5.1 2017年台湾PCB产业的发展

2.5.2 2016-2017年台湾PCB产业的发展

2.5.3 台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 2016-2017年中国PCB产业发展分析

3.1 2016-2017年我国PCB产业的发展概况

3.1.1 我国PCB产业的产值及产能

- 3.1.2 我国PCB产业的产品结构
- 3.1.3 我国PCB行业配套日渐完善
- 3.1.4 我国成全球最大PCB制造基地
- 3.1.5 我国PCB产业的发展机遇
- 3.2 PCB产业竞争力分析
 - 3.2.1 竞争对手
 - 3.2.2 替代品
 - 3.2.3 潜在进入者
 - 3.2.4 供应商的力量
- 3.3 HDI市场发展分析
 - 3.3.1 HDI市场容量
 - 3.3.2 HDI市场供求
 - 3.3.3 HDI市场趋势
- 3.4 我国PCB产业发展问题及对策
 - 3.4.1 我国PCB产业与国外存在的差距
 - 3.4.2 PCB产业发展面临的挑战
 - 3.4.3 PCB产业持续发展的措施
 - 3.4.4 PCB产业需发展民族品牌

第四章 中国印制电路板制造业财务状况

- 4.1 中国印制电路板制造业经济规模
 - 4.1.1 2016-2017年印制电路板制造业销售规模
 - 4.1.2 2016-2017年印制电路板制造业利润规模
 - 4.1.3 2016-2017年印制电路板制造业资产规模
- 4.2 中国印制电路板制造业盈利能力指标分析
 - 4.2.1 2016-2017年印制电路板制造业亏损面
 - 4.2.2 2016-2017年印制电路板制造业销售毛利率
 - 4.2.3 2016-2017年印制电路板制造业成本费用利润率
 - 4.2.4 2016-2017年印制电路板制造业销售利润率
- 4.3 中国印制电路板制造业营运能力指标分析
 - 4.3.1 2016-2017年印制电路板制造业应收账款周转率
 - 4.3.2 2016-2017年印制电路板制造业流动资产周转率
 - 4.3.3 2016-2017年印制电路板制造业总资产周转率
- 4.4 中国印制电路板制造业偿债能力指标分析
 - 4.4.1 2016-2017年印制电路板制造业资产负债率

4.4.2 2016-2017年12月印制电路板制造业利息保障倍数

4.5 中国印制电路板制造业财务状况综合分析

4.5.1 印制电路板制造业财务状况综合评价

4.5.2 影响印制电路板制造业财务状况的经济因素分析

第五章 2016-2017年PCB制造技术的研究

5.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

5.1.1 PCB芯片封装的介绍

5.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法

5.1.3 PCB芯片封装的流程

5.2 光电PCB技术

5.2.1 光电PCB的概述

5.2.2 光电PCB的光互连结构原理

5.2.3 光学PCB的优点

5.2.4 光电PCB的发展阶段

5.3 PCB技术的发展趋势

5.3.1 向高密度互连技术方向发展

5.3.2 组件埋嵌技术的发展

5.3.3 材料开发的提升

5.3.4 光电PCB的前景广阔

5.3.5 先进设备的引入

第六章 2016-2017年PCB上游原材料市场分析

6.1 铜箔

6.1.1 铜箔的相关概述

6.1.2 铜箔在柔性印制电路中的应用

6.1.3 电解铜箔产业的发展概况

6.2 环氧树脂

6.2.1 环氧树脂的相关概述

6.2.2 环氧树脂的主要应用领域

6.2.3 我国环氧树脂产业的发展现状

6.3 玻璃纤维

6.3.1 玻璃纤维的相关概述

6.3.2 我国成为全球最大玻璃纤维生产国

6.3.3 2017年我国玻璃纤维行业发展状况

6.3.4 2017年玻璃纤维产业运行分析

6.3.5 2017年玻璃纤维产业运行分析

第七章 2016-2017年PCB下游应用领域分析

7.1 消费类电子产品

7.1.1 2017年我国消费电子产品发展综述

7.1.2 2017年我国消费电子产品市场发展状况

7.1.3 2017年我国消费电子产品市场发展状况

7.1.4 消费电子用PCB市场需求稳定增长

7.1.5 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

7.2 通讯设备

7.2.1 2017年我国通讯设备制造业发展

7.2.2 2017年我国通信设备业的发展

7.2.3 2017年我国通信设备业的发展

7.2.4 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

7.3 汽车电子

7.3.1 PCB成为汽车电子市场的热点

7.3.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

7.3.3 2024年全球汽车电子PCB市场发展预测

7.4 LED照明

7.4.1 中国LED照明的发展状况

7.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

第八章 国外重点PCB制造商介绍

8.1 日本企业

8.1.1 日本揖斐电株式会社(IBIDEN)

8.1.2 日本旗胜 (Nippon Mektron)

8.1.3 日本CMK公司

8.2 美国企业

8.2.1 MULTEK

8.2.2 美国TTM

8.2.3 新美亚 (SANMINA-SCI)

8.2.4 惠亚集团 (Viasystems)

8.3 韩国企业

8.3.1 三星电机 (Samsung E-M)

8.3.2 永丰 (Young Poong Group)

8.3.3 LG Electronics

8.4 台湾企业

8.4.1 欣兴电子

8.4.2 健鼎科技

8.4.3 雅新电子

第九章 2016-2017年国内PCB上市公司经营状况

9.1 沪电股份

9.1.1 公司简介

9.1.2 2017年1-12月沪电股份经营状况分析

9.1.3 2017年1-12月沪电股份经营状况分析

9.2 天津普林

9.2.1 公司简介

9.2.2 2017年1-12月天津普林经营状况分析

9.2.3 2017年1-12月天津普林经营状况分析

9.3 生益科技

9.3.1 公司简介

9.3.2 2017年1-12月生益科技经营状况分析

9.3.3 2017年1-12月生益科技经营状况分析

9.4 超声电子

9.4.1 公司简介

9.4.2 2017年1-12月超声电子经营状况分析

9.4.3 2017年1-12月超声电子经营状况分析

9.5 超华科技

9.5.1 公司简介

9.5.2 2017年1-12月超华科技经营状况分析

9.5.3 2017年1-12月超华科技经营状况分析

9.6 上市公司财务比较分析

9.6.1 盈利能力分析

9.6.2 成长能力分析

9.6.3 营运能力分析

9.6.4 偿债能力分析

第十章 PCB行业投资分析及前景预测

10.1 PCB投资分析

10.1.1 PCB行业SWOT分析

10.1.2 PCB投资面临的风险

10.1.3 PCB市场投资空间大

10.2 PCB产业发展前景预测

10.2.1 2017年国际PCB行业发展预测

10.2.3 未来我国PCB行业将保持高速增长

10.2.4 十三五期间我国PCB产业的发展重点

10.2.5 2018-2024年我国印制电路板产业的发展前景预测

图表目录：

图表 各国家/地区PCB工厂数目

图表 全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）

图表 电子整机及PCB的应用领域和未来发展

图表 全球各国PCB产值

图表 电子工业（半导体）和PCB工业的增长

图表 全球各地区PCB产值分布

图表 全球主要手机PCB板厂家市场占有率

图表 全球PCB下游应用比例

图表 全球PCB产品结构

图表 美国PCB产值变化情况

图表 日本PCB产量统计表

图表 日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）

图表 日本PCB厂家海外产值（按国家分类）

图表 日本PCB进出口量（按国别统计）

图表 日本PCB出口量（按地区统计）

图表 日本印制电路板设备投资额

图表 台湾PCB的资本构成

图表 台湾不同种类PCB的比例

图表详见报告正文（BGZQJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/316069316069.html>